



平成 21 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社ホロン
代 表 者 代表取締役社長 穴澤 紀道
(JASDAQ・コード番号 7748)
問 合 せ 先 取締役総務部長 加藤 邦彦
電 話 03-3341-6431

当社株式の上場時価総額及び今後の展開等について

当社株式につきましては、平成20年8月の上場時価総額（月末上場時価総額）が5億円未満となりましたので、今後の見通し等につきましてお知らせいたします。

記

1. 当社株式の時価総額について

当社株式は、平成 20 年 8 月の月末上場時価総額が 5 億円未満となりました。

ジャスダック証券取引所株券上場廃止基準第 2 条第 1 項第 3 号（上場時価総額）では、9 ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を 3 ヶ月以内にジャスダック証券取引所に提出しない場合にあっては、3 ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が 5 億円以上にならない時は、上場廃止になる旨規定されております。

なお、平成 20 年 10 月 30 日付でジャスダック証券取引所より平成 20 年 10 月から同年 12 月までの間、一時的に株券上場廃止基準における上場時価総額基準の適用が停止されており、また、平成 21 年 1 月 13 日付で上場時価総額基準が 5 億円未満から 3 億円未満に平成 21 年 12 月まで一時的に変更されております。

(ご参考)

- (1) ①当社株式 平成 20 年 8 月末 (8/22) 現在のの上場時価総額
8 月末最終価格 13,100 円× 8 月末上場株式数 33,405 株
= 月末上場時価総額 437,605,500 円
- ②当社株式 平成 20 年 9 月末 (9/30) 現在のの上場時価総額
9 月末最終価格 6,300 円× 9 月末上場株式数 33,405 株
= 月末上場時価総額 210,451,500 円
- ③当社株式 平成 21 年 1 月末 (1/30) 現在のの上場時価総額
1 月末最終価格 5,200 円× 1 月末上場株式数 33,405 株
= 月末上場時価総額 173,706,000 円
- (2) ①当社株式 平成 20 年 8 月 月間平均上場時価総額 510,862,665 円
②当社株式 平成 20 年 9 月 月間平均上場時価総額 264,400,575 円
③当社株式 平成 21 年 1 月 月間平均上場時価総額 181,322,340 円

2. 事業の現状

2-1. 事業の内容

(1) マスク及びウエハ微小寸法測定装置について

当社は、半導体製造プロセスで使用されるマスク及びウエハが正しく設計されているかを電子ビームを使用し、検査・測定する装置を開発・製造・販売しております。

「半導体」とは、電気を通しやすい「導体」と電気を通さない「絶縁体」との中間の性質を持つ物質のことですが、現在、通常「半導体」と言った場合、半導体そのものではなく、半導体を用いて作られた集積回路である IC などを指しています。

半導体デバイス（※1）製造プロセスでは、マスクと呼ばれるものとウエハと呼ばれるものがあります。一般的にマスク（又はフォトマスク）とは、この製造過程で用いる原版のことで、ガラス基板上に回路パターンが描画されております。また、ウエハとは、IC の製造に使われる半導体でできた薄い基板のことでシリコン製のものが多く、これを特に「シリコンウエハ」と呼んでおります。当社の主製品は、マスク及びウエハ上の半導体の回路寸法を、電子ビームによって測定する微小寸法測定装置 CD-SEM（※2）であります。

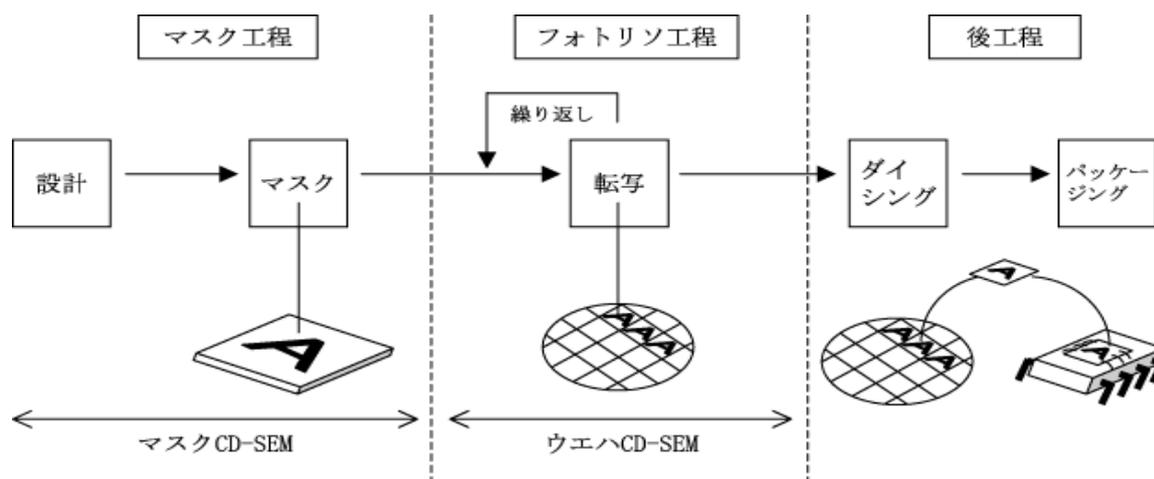
なお、半導体デバイス製造プロセスは、具体的に、ウエハ上にステッパー（縮小投影露光装置）を用いて、IC の設計パターンを、マスクを介して縮小転写して、その後ウエハにできた IC チップを切断（ダイシング）し、パッケージに搭載（パッケージング）することで製造されます。

（※1）デバイス：電子回路を構成する基本的な素子。トランジスタ・IC・LSI など。

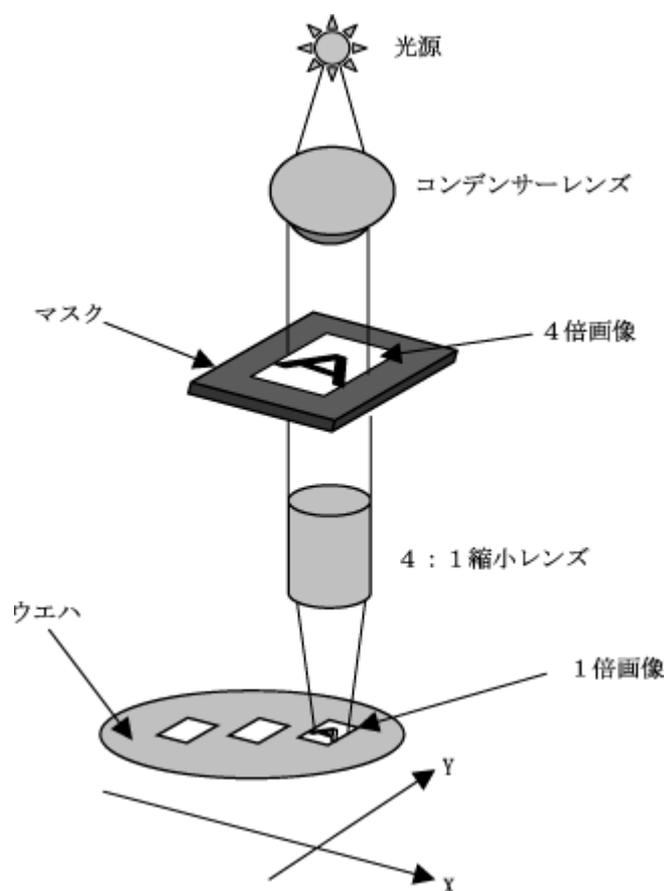
（※2）CD-SEM：「Critical Dimension-Scanning Electron Microscope」電子ビームによる超微細寸法測定装置のこと。

（ご参考）

半導体デバイス製造プロセス概念図



ステッパー（シリコン基板に集積回路のパターンを焼き付ける装置）の原理



出典：工業調査会 当社による補足説明

当社の顧客の大半は IC を製造する半導体デバイスメーカー、マスク（原版）を製造するマスクメーカーであります。

当社は設立（1985年5月）当初、ウエハ用電子ビーム微小寸法測定装置により市場開拓を行いました。半導体技術の進歩によって大きな直径のウエハの作製が可能となり、ウエハの大きさが200mm（8インチ）から300mm（12インチ）に移行するようになりました。それに伴いウエハ用寸法測定装置本体も大型化が要求され、装置開発投資の負担が大きかったことから、当社は主力製品をマスク用電子ビーム微小寸法測定装置に移行し、1998年12月に初の「EMU」シリーズを開発・発表いたしました。

（2）低加速電子ビーム高速転写装置について

半導体の種類のなかに LED（発光ダイオード）があります。

LED はセンサー、照明、交通信号など表示デバイスと応用範囲が年々広がっておりますが、高額な装置価格やメンテナンス費用等ランニングコストがかかることから、LED メーカーは低価格で量産タイプの製造装置を要望しておりました。当社はそれらの要求を受け、2006年11月、高輝度（輝度は発光体の単位面積あたりの明るさのこと）LED向けに、電子ビームを使用した低加速電子ビーム高速転写装置「EBLITHO」を開発し LED 市場へ投入し販売しております。

（3）その他事業について

その他の事業としては上記自社製品の定期点検、修理等の保守サービス及び他社と電子ビームを使用した露光技術の共同開発研究も業務の一部として行っております。

(4) 当社製品の販売過程について

通常当社が製造した装置を販売する過程において、顧客は購入を決定する際に装置の性能調査を実施します。性能調査は各社ごと多項目にわたる評価基準に基づき約1ヶ月から2ヶ月かけて判定します。これを性能評価と呼び、評価を得るということは評価項目の判定基準をクリアした性能であるということですが、最終的には、その後の装置選定は性能以外の操作性や価格等を加味した上で受注先が決定されます。

2-2. 当社事業を取り巻く環境

2006年から2007年にかけては、世界的な原油価格高騰があったものの、自動車等の輸出や個人消費に支えられ景気回復は堅調に推移しました。しかしながら、半導体産業は液晶等の薄型テレビ等の最終商品であるデジタル家電等の大幅な販売価格低下により、半導体の販売価格が低調に推移し好調と言えるまでには至っておりませんでした。

2008年5月の世界半導体市場予測(業界団体World Semiconductor Trade Statistics(WSTS)発表)によりますと、2008年の世界の半導体市場は前年比4.7%増となる見通しでした。これは、2007年の成長率(前年比3.2%増)を上回るものの、2007年11月時点の予測からは4.4ポイントの下方修正でありました。

この修正は、半導体業界では、北京オリンピックに向けてデジタル家電などの需要が拡大し、半導体設備受注も増える見込みが実際には不発であったこと、サブプライムローン問題で米国経済が後退局面に入っていること、主としてパソコンの主記憶装置などに使用される半導体メモリーであるDRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー)の価格下落の影響が長引いていることなどの減速感が背景にあると考えられます。

更にWSTSが2008年11月に発表した市場予測によりますと、2008年は前年比2.5%の微増、2009年には前年比2.2%減少しマイナス成長となり、プラスに転じるのは2010年と見ており、市場低迷が長期化するのとは必至とされております。

上記のとおり、米国発の金融危機を発端に世界的な景気減速で、今日現在半導体メモリーも需要が減退し市況の低迷は長期化しております。当社にとって最大顧客であるマスクメーカーも市場低迷と受注競争の激化などの厳しい状況下で、業績が低迷し、設備投資を抑制または手控えております。また、半導体デバイスメーカーにおきましても、デジタル家電や携帯電話の販売不振から在庫調整が始まり、生産設備を抑制し量産体制の設備投資を延期する状況にあります。

しかしながら、収益環境が厳しい状況においても技術力が業績の浮沈を左右するととらえる企業が多いことから、当社の取引先を含めた半導体メーカー各社は、次世代半導体へ向けて生産コストを引下げ、メモリーの大容量化や消費電力の低減といった製品の競争力の維持・向上を目標に大型の開発投資を続けているのも事実であります。その大型投資によって整備された量産体制の下で製品の品質を左右するのが、回路パターンをシリコンウエハ上に書き込む露光(ステッパー)技術だといわれております。近年の半導体を大量に搭載する携帯電話やデジタル家電については、半導体の回路を微細化することにより性能が向上し、受注が増加することから、半導体メーカー各社は微細化を他社に先駆けて推進することが競争力の向上につながると考えて2009年以降に向けて32nm(ナノは十億分の一)以降の半導体の開発計画を進めております。

2-3. 当社の状況

当社製品事業は「2-1. 事業の内容(1)マスク及びウエハ微小寸法測定装置について」のとおり、主力製品をウエハ用電子ビーム微小寸法測定装置からマスク用電子ビーム微小寸法測定装置に移行しましたが、当初から数年の主流はウエハ用装置でマスク用装置の販売台数は年間1~3台でした。その後、半導体デバイスの微細化に対応する装置開発を進め、2000年にマスク用電子ビーム微小寸法測定装置「EMU」をモデルチェンジして本格的にCD-SEM市場へ投入し、2002年には海外向け安全規格の認証を取得しワールドワイド・スタンダードな

測定装置を製品化しました。その結果、2002年から2005年にかけて、「EMU」シリーズは年間4～9台を販売し、第20期（平成17年3月期）には売上高2,250百万円のうち製品事業2,014百万円の約80%を占めるに至りました。

「2-2.当事業を取り巻く環境」に記載しました環境下、当社は第21期（平成18年3月期）より、マスク検査装置の需要に連動する半導体市場の変化による顧客の設備投資動向の変動に迅速な対応ができず、また、参入した競合会社の技術競争に一時遅れを取ったため、装置販売台数が落ち込みました。その原因は、当社の製品性能が相対的に競合先を上回っているという認識で、個別で異なる顧客ニーズに対し適切な対応ができていなかったこと、性能調査において、多項目にわたる評価基準に対し一部クリアできない技術面での劣後がありました。すぐに技術面での課題は克服しましたが、その後の半導体市場の低迷が影響して売上高の減少が続きました。これを受けて社内では、製造原価をはじめ販売費及び一般管理費等、特に試験研究費の軽減を目標とした経費削減に取り組んでおりました。その結果、第23期（平成20年3月期）におきましては売上高306百万円となり前期566百万円に比べ増減率は $\Delta 46.0\%$ と落ち込みましたが、営業損失は前期に比べ74百万円縮小し $\Delta 326$ 百万円、経常損失は前期に比べ52百万円縮小し $\Delta 343$ 百万円となりました。当期純損失に關しましては、役員退職慰労引当金136百万円を取崩し特別利益としたものの、工場（埼玉県所沢市）の土地及び建物等と本社（新宿区）のリース資産について減損損失206百万円を特別損失として計上したため前期に比べ11百万円損失が拡大し $\Delta 409$ 百万円となりました。

当社における売上高の著しい減少の背景は、マスクCD-SEM市場において、競合企業の参入による競争激化を契機としております。2006年以降、当社の競合大手企業が65nm対応機に焦点を合わせ、CD-SEM市場へ投入した測定装置が多くシェアを獲得し、上記のとおり当時技術競争で一部劣後していた当社は、予定していた複数の商談を落とす結果となりました。

当社は、この技術面での課題をすぐに改善し、次世代に向けた主力製品であるマスク用寸法測定装置「EMU」シリーズにおいて測定対象がこれまでの65nmに比べ、より微細化した製品を検査測定することが可能な45-32nm対応機を開発してまいりました。しかし、半導体の開発装置市場は測定対象が65-45nm対応から45-32nm対応へ移行すると予想していたものの、実際は、顧客各社は設備投資予算実行が先送りされ、45nm以降のより微細化に向けた開発を抑制し、回路線幅65nm対応製品の量産体制が2007年になっても主流のまま推移し、当社の「EMU」の販売台数は激減し、第22期（平成19年3月期）は2台（うち旧モデル改造1台）の販売、第23期（平成20年3月期）については販売できませんでした。2008年には業界最先端の回路線幅45nmの微細加工技術を採用した新型MPU（超小型演算処理装置）を搭載したノートパソコンが商品化されましたが、その後大きな進展は見られず世界の景気後退に入りました。開発装置につきましても市場は低迷しておりますが、開発投資に積極的な大手企業の要求は測定対象が32nm対応機であり、当社はそれをクリアして評価を得て、現在商談を進めております。

一方、当社は、2006年11月に、新事業領域であるLED市場へ向けLED生産用パターン転写装置である電子スタンプ「EBLITHO」を発売開始いたしました。しかしながら、販売するにあたり同装置は、LED製造過程において他の周辺技術や材料を必要といたしますが、それらの開発が遅れていたため本来の性能が十分に発揮できず受注に結びつきませんでした。そのため現在は材料メーカーの協力を得て共同開発を進めております。

また、経営体制及び資金面につきましては、2008年1月、経営成績不振の責任を明確にし富加津前社長より穴澤新社長へ交代して経営体制の立て直しを図り、同年3月には、当面の事業活動の停滞を未然に回避するための運転資金への対応として、当社の主要株主である株式会社エー・アンド・デイを割当先とする第三者割当増資の実行により199百万円の資金を調達しました。

その後、2008年11月11日発表の当社『「平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結）」（4）継続企業の前提に関する注記』に記載しましたとおり、資金面につきましては、当初同

年12月を目処に株式会社エー・アンド・デイより運転資金として300百万円を上限とした借入れによる資金協力を予定しておりましたが、経費削減等の成果もあって融資の実行を延期しておりました。しかしながらこの度、業績回復の遅れから資金不足を来す恐れがあるため2009年1月同社に対し、同年2月上旬を予定した1億円の借入れを申し込みました。

3. 実施中及び今後の施策及び事業計画

当社主力製品「EMU」の技術の最大の特徴は、技術進化に伴う半導体の微細化する回路パターンの寸法測定が可能な点にあります。「2. 事業の現状 2-2. 当社事業を取り巻く環境」のとおり、半導体業界は厳しい状況下であり、半導体メーカー各社は生産設備を抑制し量産体制の設備投資を延期しておりますが、製品の競争力の維持・向上を目標とする開発投資に積極的な大手企業は、次世代半導体へ向けて大型の開発投資を続けております。そして、最先端技術を牽引し、価格下落したデバイスに付加価値を与え市場価格を維持しようと最先端の設備投資を行っております。当社にとりまして最新鋭機「EMU-270A」は、この最先端市場で競合他社との性能競争に勝つための製品と認識すると同時に、「EMU」は、装置1台あたりの販売価格が約2～3億円と非常に高額なことから1台売れる毎の売上高の増加が見込めること、また、売上高に占める構成比が大きいことから、業績の向上に影響を与えることができる製品と認識し、主力として今後も引き続き受注獲得を目指してまず第一に取り組むべきものと考えております。

上記状況を受けて当社は、売上増加と損益の改善を経営方針として、「販売施策」、「主力製品EMUの性能アップ」、「共同開発による製品の開発」、「販路の開拓」、「予算管理の徹底」及び「資本の増強及び資金の調達」を重要課題と位置づけ、早期の黒字化にまい進いたします。

そのための具体的な取り組みにつきましては以下のとおりであります。

3-1. 販売施策

販売施策としましては、既存の顧客に対して、定期的に客先に足を運び得られた営業情報を2週間毎の営業戦略会議で技術部門に報告し、個々の顧客が何を望んでいるかを協議し、営業部と技術部の意思の統一を進めております。特に2008年1月に就任いたしました、開発・技術担当出身の穴澤新社長のもと、営業体制を大きく見直した点は、営業部門と技術部門での顧客情報の共有化であります。通常、顧客ニーズは営業担当者を通して技術員に報告されますが、情報伝達時のタイムラグや内容の取り違えを少なくするため、営業担当者が顧客訪問の際に技術員を同行させる回数を増やし、常に顧客ニーズの確度を高めて迅速な対応ができる体制作りを推進しております。

また、「EMU-270A」を最高性能の最先端装置と位置づけ、研究開発を継続して市場投入する一方、前モデルとなる「EMU-270」は収差補正装置というユニットを搭載しないことから製造コストが低減されるため製造・販売を継続し、性能及び価格面の違いから両装置を完全に差別化し、特に中国や台湾等の量産ベースの追加設備や古い設備の更新として購入する市場向けに、現地の販売代理店を活用して販促活動を進めております。

3-2. 主力製品EMUの性能アップ

「EMU-270」につきまして、次世代の32nm以降にも対応させるために、収差補正装置を導入して分解能（器械装置などで物理量を測定・識別できる能力）を大幅に向上させるため研究開発を継続しております。その結果、低真空機能（装置内を低真空にすることで絶縁物試料の観察や分析が有効）と収差補正機能（レンズの収差を補正することでより高品位な画像を提供）を織り込んで進化した「EMU-270A」を開発・製作するに至りました。現在のマスクCD-SEMにおいて低真空機能を採用する機種は他になく、収差補正機能においては当社オリジナルの技術であることからこれを特色とし、最先端市場で競合他社との性能競争に勝ち抜くための最新鋭機として位置づけ、商品力の向上を図っております。現在の最重要案件は、国内大手半導体デバイスメーカー向けに早期の受注獲得を目指し、低真空機能及び高分解能という優位性を前面に押し出し商談を進め、すでに3回のデモを実施して評価を得ております。

また、更なる性能アップに向け、当社の主要株主である株式会社エー・アンド・デイの技術協力を得て、次世代向け製品の基本性能アッププロジェクト・チームを立ち上げ、活動を開始しております。内容につきましては、「3-3. 共同開発による製品の開発（3）株式会社エー・アンド・デイとの共同開発」をご参照ください。

3-3. 共同開発による製品の開発

当社の主力製品であるマスク用寸法測定装置「EMU」は、装置1台あたりの販売価格が約2～3億円と非常に高額であり1台売れる毎の売上高の増加が見込める反面、当社の売上構成上マスク用寸法測定装置に大きく依存している状況から、計画通りに販売できない場合、業績を不安定にするリスクが顕在しております。従って、今後も主力製品である「EMU」を中心に販売活動を行ってまいります。また、「EMU」以外の新製品の開発に努め、製品のラインアップの充実を図り売上高を増加させるとともに上記リスク低減を図ってまいります。

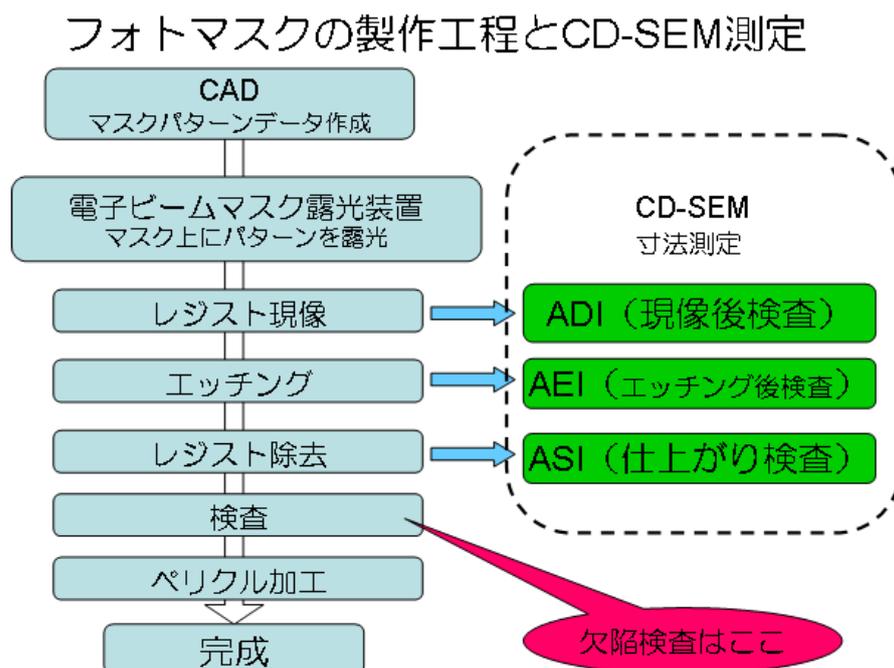
現在共同開発に取り組んでいる案件は以下のとおりであります。

(1) マスク用レビューSEM「DIS」の共同開発

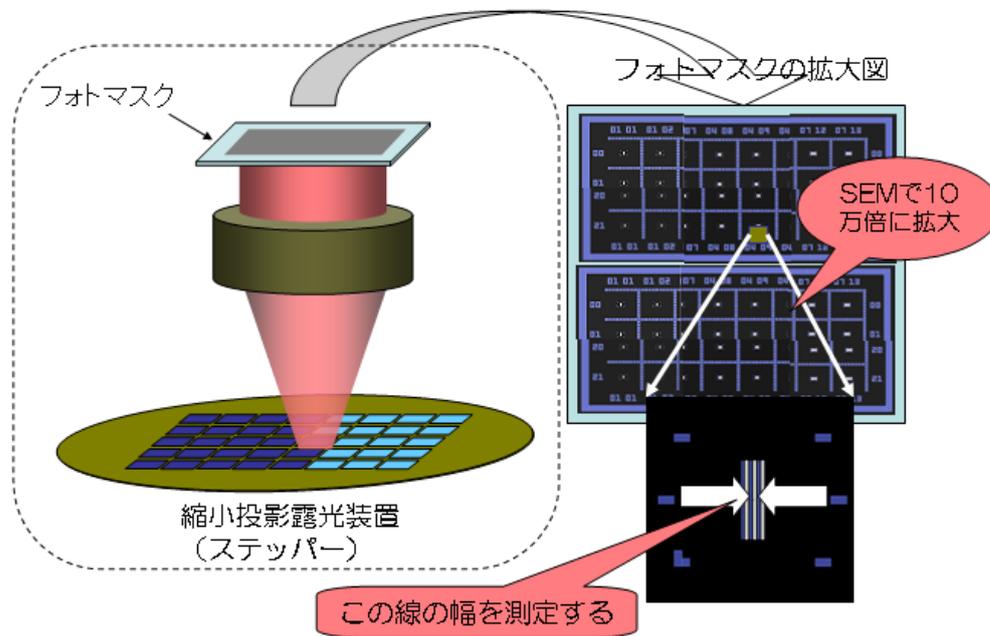
2005年8月、マスクの歩留まり向上に大きな威力を発揮すると期待してマスク用欠陥検査装置「DIS-05」を発表いたしました。この装置は寸法測定装置「EMU」のようにマスクに描画された回路の線幅を測定するのに対し、「DIS」は、設計パターンとマスクに描画されたパターンの違いを検出したり、パターンの比較を行うことによって形状の差を検出し、欠陥の有無を判定する新たなコンセプトの製品であります。発売当初には良い評価を得ていましたが、商談が進むに連れ、より高度な分解能でのマスク欠陥検査結果を要求する顧客を満足させるに至らず販売に結びつきませんでした。現在は協力企業との間でソフトウェア面での共同開発による改良を続けております。

本開発は、すでに当社のCD-SEM装置が納入されている台湾の顧客と、顧客からの紹介を得たパターンのシミュレーションシステムを行う米国企業との共同開発によって進められ、マスク欠陥の判定プロセスを大幅に短縮することを可能にして、顧客ニーズに応えた低価格の装置の製品化を目指しております。

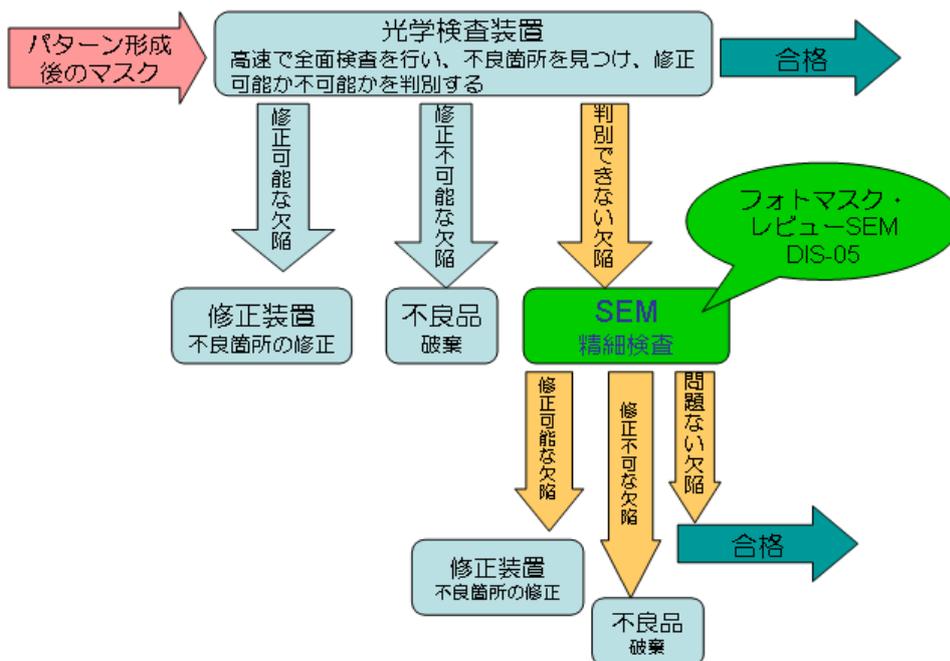
(ご参考)



CD-SEMは何を測るか



フォトマスクの欠陥検査の流れとDIS-05



(2) 電子スタンプの共同開発

当社製品「EBLITHO」の納入先である LED メーカーの協力を得た共同開発の成果として、発光面に微細な凹凸構造を正確なパターン間隔で迅速に転写するため LED の量産が可能になりましたが、生産コストにおきましては、市販の電子線用レジスト（感光材）が高額のため、部品そのものが安価な LED ではコストが見合わず、安価な電子線用レジストの開発が必要になりました。当社は今期より、当社顧客のマスクメーカー及び感光材料メーカーの協力を得て開発に取り組み、安価なレジスト供給が確保されたことから滞っていた商談を進めております。

(3) 株式会社エー・アンド・デイとの共同開発

最新鋭機「EMU-270A」は「EMU-270」に比べ、収差補正装置というユニットを搭載しているためコスト高になっているものの高精度な測定を実現しております。これに対し、株式会社エー・アンド・デイとの共同開発は、同社の保有する卓越したアナログ・デジタル回路技術を活用することにより測定再現精度の向上や、高速の並列処理技術を導入して作業処理能力の高速化を図るなど技術面での開発であります。

2008 年 12 月、同社のクリーンルームに当社「EMU-270」を設置し、次世代向け製品の基本性能アッププロジェクト・チームを立ち上げ、必要に応じて当社技術者を派遣させるなどして活動を開始しております。活動目標は「EMU の低雑音化」とし、装置の電気信号に含まれる電気ノイズを少なくし、画像を鮮明にして測定精度を向上させるものです。2009 年 6 月を期限に第 1 開発期間として、装置の部分的な範囲での低雑音化を図り、終了後から同年 12 月までを第 2 開発期間として、装置全体の低雑音化による性能向上を計画しております。

3-4. 販路の開拓

現在、当社は国内と韓国に事業所を有しており、欧米と台湾におきましては代理店販売を行っております。市場地域として中国では、2001 年に大手半導体メーカーへ CD-SEM を直接販売し、納入後現地代理店契約を結ぶ予定で調査しましたが、代理店としてのサービス技術力と販売力が不足していたため、市場へ進出するきっかけが見出せず契約は結びませんでした。しかし、その後も情報収集を続けました結果、当社の代理店として相応しい企業が見つかり、サービス及び販売の強化を目的として、2008 年 5 月に中国 MARKETECH INTERNATIONAL CORP (MIC) 社と新代理店契約を締結いたしました。MIC 社は、1988 年台湾で創立され、本部は台北にあり、中国、シンガポール、韓国、日本と米国に海外支社を有し、マーケティングとテクノロジー統合サポートサービスを専門とする代理店であります。中国市場におきましても CD-SEM 装置の需要は増加しつつあり、設備投資予算の申請の段階に達している半導体メーカーが多く見受けられることから、代理店契約締結後すぐに営業活動が開始されております。

また、新規顧客開拓の手段の一つとして注力しておりますのが、世界の市場に対応するため、半導体関連の学会への参加（2008 年 2 月米国、4・5 月日本、7 月中国）、展示会への出展（2008 年 4・7・10・12 月日本）であります。学会への参加につきまして、当社は高度な技術を基本としているため学会への参加は不可欠と考え、常に最新の技術を吸収するとともに当社の保有する技術を広く知っていただくことを目的とし、セミコン・ジャパン（半導体を中心としたマイクロエレクトロニクスの製造を支える装置・材料産業の世界を代表する総合イベント）2008（12 月 3 日～5 日幕張メッセ）等展示会への出展では、半導体関連企業が一堂に会す貴重な機会ですので、当社製品の紹介は勿論のこと顧客との交流や他社の情報収集をもとに新規顧客の発掘に努めております。

3-5. 予算管理の徹底

(1) 原価低減の取り組み

設計部門としましては、設計品質を向上させ、追加工、手直しを‘0’にするため、設計上のミス、無駄をなくすよう部内において設計者以外による発注前の図面のチェックを

周知徹底しております。設計資産である設計図面の有効利用として、類似した図面作成時に新たに初めから設計するのではなく、図面の変更で済ませることにより設計工数を削減し、また、部品の共通化を進めることにより材料及び保守部品等の在庫を減らし、スケジュール管理を適切に行うことで部品発注の時期の適正化を計り、在庫品の低減（前年比10%減目標）に努力しております。

今後はさらなる設計品質向上のため、設計審査（設計部門が作成した設計案を製造、開発部門など他の部門が参加して評価する）体制の整備を見直し、設計審査手順を明確にして確実に機能させ、今まで見落としがちであった設計上のミス、無駄をなくし、その成果の判定を確実に行うとともに、設計者に随時フィードバックしながら設計品質向上を行い、原価の低減（前年比10%減目標）を実現していきたいと考えております。

製造部門としましては、組立、調整工数の削減を目標に、組立、調整業務の改善活動を行っております。手段につきまして、製造者の立場から組立、調整がしやすく工数削減に効果があると思われる改善提案を部内で取りまとめ、採用された案については早急に実施していく方針であります。現在、個人毎が行っていた改善提案を製造部内で組織として行うための仕組みを作り、試行しております。

(2) 人件費の削減及び固定資産購入の見直し

役員報酬及び給与手当につきましては、株価下落及び業績不振の責任を明確にするため、平成20年4月より、役員報酬につきましては、代表取締役社長30%、取締役相談役20%及び取締役につきましては給与手当部分の10%削減を実施しており、今後も継続いたします。本施策により年間12百万円の削減を見込んでおります。

平成20年12月の冬季賞与につきましては、ライン業務の実行責任に鑑み、例年支給しております部長職に対しての支給を見送ることで3百万円の削減を実施しました。

この結果、今後1年間の人件費の年間削減額合計は15百万円の見込みとなります。

有形、無形固定資産及び投資につきましては、平成21年3月期予算計上額は6百万円です。その内容は、設計業務の省力化、効率化を図るための設備品（オシロスコープ、3D-CAD等）ではありますが、業績不振の折、予算を凍結することにより5百万円を削減する見込みです。但し、安全衛生面及び法規制上必要な設備品が発生した場合によっては、必要最小限の購入に止めることといたします。

3-6 資本の増強及び資金の調達

2008年3月、資本増強策として、当社の主要株主である株式会社エー・アンド・デイを割当先とする第三者割当増資を実施し199百万円の資金を調達しました。

手取金の使途として100百万円相当は、主力製品「EMU-270A」の性能アップのための収差補正装置等の購入代金支払いに使用いたしました。収差補正機能を搭載した「EMU-270A」は、2008年2月に受注し、同年4月に同装置代金の支払を行い、同年7月に米国向け出荷しております。

残金99百万円につきましては、電子スタンプ「EBLITHO」の本格的量産タイプの製品開発等に充当しております。この開発計画を実行するため、2008年4月にプロジェクトチームを結成し、現在も活動を継続しております。開発の具体的内容は、同装置の作業処理能力と精度の向上や関連消耗品の長寿命化などです。

また、2008年11月11日発表の当社『「平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結）」（4）継続企業の前提に関する注記』に記載しましたとおり、資金面につきまして、当初同年12月を目処に株式会社エー・アンド・デイより運転資金として300百万円を上限とした借入れによる資金協力を予定しておりましたが、経費削減等の成果もあって融資の実行を延期しておりました。しかしながらこの度、業績回復の遅れから資金不足を来す恐れがあるため2009年1月同社に対し、同年2月上旬を予定した1億円の借入れを申し込みました。これ

は、同年4月末の製品売上入金予定までの間の運転資金として充当する予定であります。

4. 今後について

当社は、今後も装置の性能面での優位性を確保しながら、顧客ニーズを的確に把握し対応できる体制、また、主力製品「EMU」一本の商品構成から脱却して、より柔軟に対応する新しい体制を基にした営業活動の強化に取り組み、まずは、当期に計画している商談の早期成立を目指し最大限の努力を払ってまいります。そして、当社は引き続き上場維持に向けて安定的な収益力を確保するために、全社一丸となって取り組んでまいります。

なお、本書面をジャスダック証券取引所に提出することにより、平成21年8月末日までのいずれかの月において、月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が3億円以上となったときは、同株券上場廃止基準に該当しないことになります。

株主、投資家の皆様のご理解を頂き、企業価値を高めて行くことで上場を維持してまいりたいと考えております。

以上

(ご参考)

平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年11月10日発表のとおりであります。

業績

(単位：百万円)

	第22期 平成19年3月期		第23期 平成20年3月期		第24期 平成21年3月期	
	中間期 (実績)	通期 (実績)	中間期 (実績)	通期 (実績)	第2四半期 (実績)	通期 (見込)
売上高	105	566	106	306	104	870
経常利益	△260	△396	△180	△343	△473	△278
当期純利益	△265	△398	△386	△409	△482	△287

最近の株価の状況

(単位：円)

	第23期 平成20年3月期	第24期 平成21年3月期
上期平均終値 (4月1日～9月30日)	43,962	16,346
下期平均終値 (10月1日～3月31日)	30,367	—
通期平均終値 (4月1日～3月31日)	37,165	—